

# プログラム名 第6回 高温電子セラミックスワークショップ

英文プログラム名 The 6<sup>th</sup> Workshop on High Temperature Electroceramics

開催日:2015年3月18日(水)10:00~12:00 開催場所:I会場

主催団体名:日本セラミックス協会電子材料部会 高温電子セラミックス研究会

概要 開催内容:高温で電子機能を発現する「高温電子セラミックス」は、セラミックスの特徴を活かした新たな展開であり、かつ産業界からは多くの期待が寄せられている。本研究会では、耐熱性を指向した電子セラミックスを「高温電子セラミックス」として整理し、今回は主に高温動作型半導体パワーモジュール部材間の接合技術についてご講演頂きます。この要素技術分野を代表する下記の先生方にご講演頂くと共に、参加者間の縦断的な研究交流の輪を構築します。

参加対象者:高温電子セラミックスに興味のある方ならどなたでも

参加費:無料

予定参加者数:30-50名

申込方法:下記の連絡者まで Email にて。  
当日の参加受付も可能です。

交流会(懇親会)開催予定:なし

その他・備考:

ご講演いただく講師の先生方

高橋 学 先生 (愛媛大学)

福田 真治 先生 (FCRA)

村田 卓也 先生 (山口大学)

連絡先

名前:永田 肇

勤務先:東京理科大学 理工学部

勤務先所在地:千葉県野田市山崎 2641

T E L:04-7124-1501+3700

F A X:04-7122-9542

E - m a i l:h-nagata@rs.noda.tus.ac.jp